



“有机硅、液晶环氧双重改性塑封用高性能环氧基料的研制及产业化”通过验收

文章来源: 国科控股

发布时间: 2012-08-09

【字号: 小 中 大】

8月8日, 由中科院广州化学有限公司承担并完成的广州市科技支撑计划项目“有机硅、液晶环氧双重改性塑封用高性能环氧基料的研制及产业化”(项目编号: 2009Z2-D711)通过项目验收。

该项目以电子元器件及集成电路塑封用高性能环氧基料的研制及产业化为目标, 历时两年, 采用有机硅、高分子液晶等改性环氧树脂, 结合高分子杂化制备技术, 制备出具耐热性、韧性和介电性等综合性能符合电子塑封要求的高性能环氧基料, 已达到国际先进水平, 能够满足高端封装市场的需求。本项目在研究期间, 在国内外学术期刊上共发表文章20篇, 申请国内专利5件。

验收组专家在听取了项目的工作总结报告, 审阅了验收相关材料并考察了项目实施现场后一致认为, 该项目成功开发出了一种符合电子塑封要求的综合性高性能环氧基料, 完成了项目任务的预期目标, 同意该项目结题验收。

该项目是广州化学作为广东省电子聚合物重点实验室和广州市电子信息聚合物行业工程技术中心的依托单位, 在塑封用高性能环氧树脂的研发方面取得的又一项成果。

打印本页

关闭本页